

## ECE認定プログラム コース

## 要素技術コース

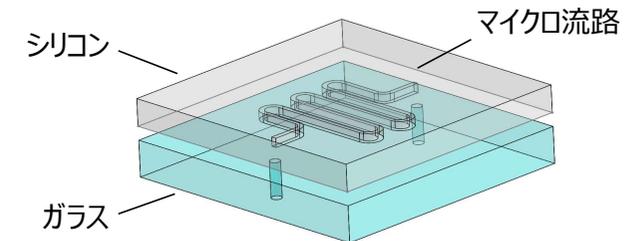
| 要素プロセス技術1<br>リソグラフィコース |                        | 要素プロセス技術2<br>エッチングコース |                       | 要素プロセス技術3<br>成膜コース |                    |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1                      | フォトリソグラフィ<br>両面マスクアライナ | 3                     | シリコン異方性エッチング          | 12                 | パリレン薄膜形成<br>パリレン   |
| 14                     | 加工表面観察                 | 7                     | シリコンドライエッチング<br>D-RIE | 13                 | 金属薄膜形成1<br>ECRスパッタ |
| 15                     | レジスト塗布<br>コータデベ        | 8                     | ガラスドライエッチングNLD        | 15                 | レジスト塗布<br>コータデベ    |
| 16                     | 転写プロセス<br>ナノインプリント     | 14                    | 加工表面観察                | 17                 | 金属薄膜形成2<br>4元スパッタ  |

## デバイスコース

| デバイス1<br>バルクマイクロマシニング海老名集中コース<br>(ナノ・マイクロ流路形成) |              | デバイス2<br>サーフェスマイクロマシニングコース<br>(電極/配線形成) |                        |
|--|--------------|---|------------------------|
| 2  | シリコン酸化       | 1                                       | フォトリソグラフィ<br>両面マスクアライナ |
| 3  | シリコン異方性エッチング | 7                                       | シリコンドライエッチング<br>D-RIE  |
| 4  | ナノパターン形成     | 13                                      | 金属薄膜形成1<br>ECRスパッタ     |
| 6  | 陽極接合         | 15                                      | レジスト塗布<br>コータデベ        |

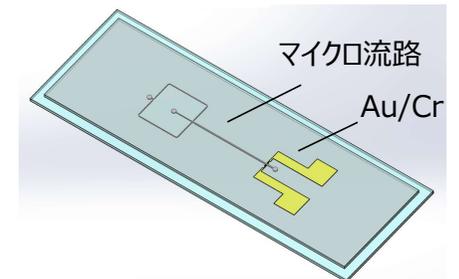
シリコンマイクロ流路の例)

実習はシリコンマイクロ流路形成と陽極接合



電極/配線の例)

実習はAu/Crスパッタとウェットエッチング



ECE認定プログラム

要素プロセス技術1, 2, 3, デバイスコース1, 2

ECE認定基準

3/4以上受講

満たない場合、レポート（アンケート）提出